



Title of Change:	TQFP Assembly Site Transfer from J-Devices Usuki to ASE Shanghai		
Proposed First Ship date:	1 October 2019		
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Keiji.Ueda@onsemi.com>		
Samples:	<p>Samples should be available after completion of qualification.</p> <p>Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.</p>		
Type of Notification:	<p>This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. IPCNs are typically issued 30 days prior to the issuance of the Final Change Notice (FPCN). An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan.</p> <p>The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com></p>		
Change Part Identification:	Affected products will be identified with marking code from new plant		
Change Category:	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____		
Change Sub-Category(s):	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input checked="" type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____		
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: All Sites	External Foundry/Subcon Sites: ASE Shanghai	
Description and Purpose:			
	Before Change Description	After Change Description	Remarks
Assembly manufacturing location	J-Device Usuki, Japan	ASE Shanghai, China	Different assembly location
BOM (L/frame)	Cu Alloy 6.5mm SQ	Shinko - C7025 7mm SQ	Same l/frame material but different die attached pad size
BOM (die attach epoxy)	Loctite - ABLEBOND3230	Sumitomo - 1076WA conductive	Same conductive epoxy but different supplier
BOM (wire)	Tanaka - 4N 20um Au wire	Heraeus - 4N 20um Au wire	Same wire material but different supplier
BOM (mold compound)	Sumitomo - G700Y	Hitachi - CEL-9240	Different mold compound supplier
Surface finishing	SnBi	Pure Sn	Different material of surface finishing
Packing Tray	TRAY-OT-003T-4 (150°C max)	JT4141404-01 (150°C max)	Same tray material and dimension. Only label different
	From	To	Remarks
Product marking change	Assembly plant code 'G'	Assembly plant code 'H'	Same marking format and size. Only plant code different
No package dimension change.			
No testing site, No electrical characteristic change.			



Qualification Plan:

QV DEVICE NAME LC823432TAK

RMS #53966

PACKAGE: TQFP 128LD

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JA108	Ta=125°C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Temp= 150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260°C	
THB	JESD22-A101	Temp=85°C, RH=85%, bias = 100% of rated V or 100V max A101	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc
AC	JESD22-A102	121°C/100% RH/15 PSIG	96 hrs

QV DEVICE NAME LC823425-12G1-H

RMS #53683

PACKAGE: TQFP 128LD

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JA108	Ta=125°C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Temp= 150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 260°C	
THB	JESD22-A101	Temp=85°C, RH=85%, bias = 100% of rated V or 100V max A101	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc
AC	JESD22-A102	121°C/100% RH/15 PSIG	96 hrs

Estimated date for qualification completion: 31 August 2019

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
LC823425-12G1-H	LC823425-12G1-H
LC823425-12G1-LR-H	LC823425-12G1-H
LC823432TAK-2H	LC823432TAK-2H

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号: IPCN22640X

発行日: 20 February 2019

変更件名:	ジェイデバイス臼杵から ASE 上海への TQFP 組み立て拠点の移管																																									
初回出荷予定日:	1 October 2019																																									
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Keiji.Ueda@onsemi.com> にお問い合わせください。																																									
サンプル:	認定完了後にサンプルの提供が開始されます。 現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。																																									
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。 IPCN は、通常、最終変更通知 (FPCN) の発行の 30 日前に発行されます。 IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。 また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。 この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。 ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。																																									
変更部品の識別:	影響を受ける製品は新しい工場のマーキングコードで識別できます																																									
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他																																									
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他:																																									
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: 全拠点	外部製造工場 / 下請業者拠点: ASE Shanghai																																								
説明および目的:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組み立て拠点</td> <td>J-Device Usuki, Japan</td> <td>ASE Shanghai, China</td> <td>異なる組み立て場所</td> </tr> <tr> <td>リードフレーム</td> <td>Cu Alloy 6.5mm SQ</td> <td>Shinko - C7025 7mm SQ</td> <td>同じリードフレーム材料、異なるパッドサイズ</td> </tr> <tr> <td>ダイ接着剤</td> <td>Loctite - ABLEBOND3230</td> <td>Sumitomo - 1076WA conductive</td> <td>同じ導電エポキシ、異なるサプライヤ</td> </tr> <tr> <td>ワイヤ</td> <td>Tanaka - 4N 20um Au wire</td> <td>Heraeus - 4N 20um Au wire</td> <td>同じワイヤ材料、異なるサプライヤ</td> </tr> <tr> <td>モールド・コンパウンド</td> <td>Sumitomo - G700Y</td> <td>Hitachi - CEL-9240</td> <td>異なるモールドコンパウンドサプライヤ</td> </tr> <tr> <td>リード表面仕上げ</td> <td>SnBi</td> <td>Pure Sn</td> <td>異なるリード表面仕上げ材料</td> </tr> <tr> <td>梱包トレイ</td> <td>TRAY-OT-003T-4 (150°C max)</td> <td>JT4141404-01 (150°C max)</td> <td>同じトレイ材料と寸法。ラベルのみが異なる</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製品マーキング変更</td> <td>Assembly plant code 'G'</td> <td>Assembly plant code 'H'</td> <td>同じマーキングフォーマットとサイズ。工場コードのみが異なる</td> </tr> </tbody> </table>			変更前の表記	変更後の表記	備考	組み立て拠点	J-Device Usuki, Japan	ASE Shanghai, China	異なる組み立て場所	リードフレーム	Cu Alloy 6.5mm SQ	Shinko - C7025 7mm SQ	同じリードフレーム材料、異なるパッドサイズ	ダイ接着剤	Loctite - ABLEBOND3230	Sumitomo - 1076WA conductive	同じ導電エポキシ、異なるサプライヤ	ワイヤ	Tanaka - 4N 20um Au wire	Heraeus - 4N 20um Au wire	同じワイヤ材料、異なるサプライヤ	モールド・コンパウンド	Sumitomo - G700Y	Hitachi - CEL-9240	異なるモールドコンパウンドサプライヤ	リード表面仕上げ	SnBi	Pure Sn	異なるリード表面仕上げ材料	梱包トレイ	TRAY-OT-003T-4 (150°C max)	JT4141404-01 (150°C max)	同じトレイ材料と寸法。ラベルのみが異なる		変更前	変更後	備考	製品マーキング変更	Assembly plant code 'G'	Assembly plant code 'H'	同じマーキングフォーマットとサイズ。工場コードのみが異なる
	変更前の表記	変更後の表記	備考																																							
組み立て拠点	J-Device Usuki, Japan	ASE Shanghai, China	異なる組み立て場所																																							
リードフレーム	Cu Alloy 6.5mm SQ	Shinko - C7025 7mm SQ	同じリードフレーム材料、異なるパッドサイズ																																							
ダイ接着剤	Loctite - ABLEBOND3230	Sumitomo - 1076WA conductive	同じ導電エポキシ、異なるサプライヤ																																							
ワイヤ	Tanaka - 4N 20um Au wire	Heraeus - 4N 20um Au wire	同じワイヤ材料、異なるサプライヤ																																							
モールド・コンパウンド	Sumitomo - G700Y	Hitachi - CEL-9240	異なるモールドコンパウンドサプライヤ																																							
リード表面仕上げ	SnBi	Pure Sn	異なるリード表面仕上げ材料																																							
梱包トレイ	TRAY-OT-003T-4 (150°C max)	JT4141404-01 (150°C max)	同じトレイ材料と寸法。ラベルのみが異なる																																							
	変更前	変更後	備考																																							
製品マーキング変更	Assembly plant code 'G'	Assembly plant code 'H'	同じマーキングフォーマットとサイズ。工場コードのみが異なる																																							
	パッケージ寸法に変更なし。																																									
	テスト拠点と電気特性に変更なし。																																									



認定計画:

認定試験用ピークル: LC823432TAK

RMS #53966

パッケージ: TQFP 128LD

テスト	仕様	条件	時間
HTOL	JA108	Ta=125°C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Temp= 150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260°C	
THB	JESD22-A101	Temp=85°C, RH=85%, bias = 100% of rated V or 100V max A101	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc
AC	JESD22-A102	121°C/100% RH/15 PSIG	96 hrs

認定試験用ピークル: LC823425-12G1-H

RMS #53683

パッケージ: TQFP 128LD

テスト	仕様	条件	時間
HTOL	JA108	Ta=125°C, bias at 1.2X Nominal (not to exceed max rated)	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Temp= 150°C	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 260°C	
THB	JESD22-A101	Temp=85°C, RH=85%, bias = 100% of rated V or 100V max A101	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc
AC	JESD22-A102	121°C/100% RH/15 PSIG	96 hrs

認定完了予定日: 2019/08/31

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
LC823425-12G1-H	LC823425-12G1-H
LC823425-12G1-LR-H	LC823425-12G1-H
LC823432TAK-2H	LC823432TAK-2H

Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
LC823425-12G1-H		LC823425-12G1-H
LC823425-12G1-LR-H		LC823425-12G1-H
LC823432TAK-2H		LC823432TAK-2H